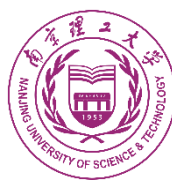


协办方



技术支持



ICICM 2021

第六届集成电路与微系统国际会议

征稿通知

中国南京

2021年10月22-24日

委员会

大会顾问主席

David Z. Pan, 德州大学奥斯汀分校, 美国 (IEEE 会士, SPIE 会士)

Ljiljana Trajkovic, 西门菲莎大学, 加拿大 (IEEE 会士)

大会主席

Zhigong Wang, 东南大学, 中国

Li Qiang, 电子科技大学, 中国

程序委员会

Fei Yuan, 瑞尔森大学, 加拿大 (IET 会士)

Zou Zhuo, 复旦大学, 中国

Liu Dake, 北京理工大学, 中国 | 林雪平大学, 瑞典

指导委员会主席

Huang Le Tian, 电子科技大学, 中国

会议投稿

投稿链接: <https://easychair.org/conferences/?conf=icicm2021>

文章模板: <http://icicm.net/files/Template.doc>

会议接收全文和摘要投稿, 需要发表文章的作者请提交全文; 仅参会做报告的作者提交摘要即可, 摘要和报告内容不会被发表。

// 扫描微信二维码分配
会议管家获取快速回复 //



投稿主题

征稿主题包括但不限于以下内容:

- *数字、模拟、混合信号 IC 和 SOC 设计技术
- *硅集成电路与制造
- *低功率、射频设备和电路
- *集成电路计算机辅助设计技术
- *硅锗器件与器件物理
- *互连、低 K、高 K 等工艺技术
- *非常规和纳米电子学
- *有机半导体器件与技术
- *复合半导体器件和电路
- *显示器、传感器和 MEMS
- *半导体材料与材料特性
- *包装检测技术
- *太阳能电池及其他新能源设备
- *建模与仿真
- *设备技术
- *可靠性
- *显示器、传感器和 MEMS
- *高级存储技术 (闪存、FERAM、PCM、RERAM、MRAM 等)

重要日期

2021年6月30日

征稿截止日期

2021年7月20日

录用通知时间

2021年8月10日

注册截止日期

联系方式

曾老师

邮箱: icicm@young.ac.cn

电话: 028-87777577

本次会议收录并注册的文章将作为会议论文集出版并提交 Ei Compendex 和 Scopus 等知名数据库检索。

2016-2020 年的会议论文集已全被录入 IEEE Xplore 数据库, 并已被 EI 核心数据库检索。2016-2019 会议论文集已被 Scopus 检索!

更多会议信息请访问
<http://icicm.net/>

